

## 上海万业企业股份有限公司 关于认购上海半导体装备材料二期私募投资基金的 进展情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、基本情况

2022年12月23日，上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会临时会议审议通过了相关议案并披露了《关于拟认购上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-064），公司拟以自有资金4亿元人民币认购上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）（后经工商核准，正式命名为“上海半导体装备材料二期私募投资基金”（以下简称“基金”））的份额。该议案已于2023年1月10日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，详情请见公司《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-001）。

2023年5月25日，基金参与各方正式签署《上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。2023年6月28日，基金在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。2024年6月12日，上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）有限合伙人转让其持有的合伙企业的认缴出资份额，且合伙企业进行后续募集吸收增加有限合伙人，合伙企业的认缴出资总额调整至20.245亿元人民币。2024年6月26日，基金在中国证券投资基金业协会完成变更备案

手续。2024年9月25日，合伙企业增加一位有限合伙人，合伙企业的认缴出资总额调整至21.245亿元人民币，并办理完成工商变更登记手续。详情请见公司于上海证券交易所网站披露的《关于认购上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）的进展情况公告》（公告编号：临2023-026）、《关于认购上海半导体装备材料二期私募投资基金的进展情况公告》（公告编号：临2023-033）、《关于认购上海半导体装备材料二期私募投资基金的进展情况公告》（公告编号：临2024-035）、《关于认购上海半导体装备材料二期私募投资基金的进展情况公告》（公告编号：临2024-037）、《关于认购上海半导体装备材料二期私募投资基金的进展情况公告》（公告编号：临2024-048）。

## 二、进展情况

2024年10月12日，公司收到合伙企业通知，该基金已在中国证券投资基金业协会完成变更备案手续，具体信息如下：

基金名称：上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）

备案编码：SB2172

管理人名称：上海半导体装备材料产业投资管理有限公司

托管人名称：南京银行股份有限公司

## 三、风险提示

公司将密切关注合伙企业的后续进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2024年10月15日